

SKC, 반도체 공정기술에 도전!

반도체 웨이퍼 표면 연마패드 개발 ... 국내 시장규모 250억원

SKC(대표 김수필)가 반도체 웨이퍼(기판) 제조공정 가운데 평탄화 공정에 사용되는 제품인 화학적 기계연마 패드를 순수 독자기술로 개발하고 하반기부터 본격적인 양산체제에 돌입한다.

CMP 패드(Chemical Mechanical Polishing PAD)는 배선 평탄화 과정에서 반도체 웨이퍼 표면을 얇고 정밀하게 깎아내는 일종의 연마제로 제조특허를 다수 보유한 미국 로텔이 세계시장의 95% 이상을 독점하고 있어 그동안 시장 진입이 어려운 것으로 평가받아 왔다.

SKC는 2001년부터 울산 및 청주 기술연구소에서 산학협동으로 CMP R&D 시설을 별도로 완공하는 등 약 2년 동안의 연구개발을 통해 독자기술을 확보하게 됐다.

현재 국내 반도체 생산기업과 공정 테스트를 진행하고 있으며, 클린룸 등 생산설비를 확충해 2003년 하반기부터 양산에 돌입할 예정이다.

SKC의 반도체 공정관련 신규사업 계획이 순조롭게 진행된다면 약 250억원에 이르는 국내 CMP PAD 시장에서 새로운 공급자로서 역할할 것으로 기대된다.

한편, SKC는 Oxide PAD 시장에 대한 집중공략에 이어 2004년 초에는 Metal PAD 시장에도 새로운 제품을 선보이며, 약 2500억원에 이르는 해외시장 개척도 본격화할 계획이다. <조인경 기자>

<Chemical Journal 2003/06/12>